

## Etude de faisabilité pour la fabrication de circuits imprimés

Nous vous sollicitons pour savoir si vous êtes en mesure de prendre en charge la fabrication de ces circuits dans les conditions suivantes :

Ces circuits sont destinés à être installés dans un satellite, ils devront donc être agréés Spatial.  
Voici un bref descriptif des circuits que nous souhaitons réaliser :

Ce sont des circuits : Simple face

Substrat : KAPTON sans adhésif, épaisseur 25 ou 50 Microns

Épaisseur Cuivre de base : 3 ou 5 Microns

Traitement compatible avec le bonding aluminium : Nickel 3 Microns, Or 0,5 Microns

Les dimensions de ces circuits par modèles sont les suivantes :

Positions	Numéros	Dimensions	Quantité
1	1093-710-C	74 x 48 mm	230 pièces
2	1093-723-B	100 x 340 mm	8 pièces
3	1093-729-B	100 x 390 mm	24 pièces
4	1093-728-B	100 x 430 mm	15 pièces
5	1093-727-B	100 x 460 mm	29 pièces
6	1093-725-B	100 x 500 mm	34 pièces
7	1093-724-B	100 x 550 mm	72 pièces
8	1093-722-B	100 x 590 mm	10 pièces
9	1093-721-B	100 x 630 mm	15 pièces
10	1093-720-C	100 x 670 mm	29 pièces
<b>Total :</b>			<b>466 pièces pour 10 positions</b>

Dimension des traces et des isolations :

Sur l'ensemble des circuits :

Les pistes font : 70  $\mu$

Les isolations sont de : 60  $\mu$

Pour le circuit (position 1), dans la zone d'interconnexion (plage de bonding) et pour les autres positions sur la partie en bout au centre sur l'axe le plus long :

Les pistes font : 50  $\mu$

Les isolations sont de : 18  $\mu$

Ces valeurs sont situées dans une zone de 50 x 100 mm

Vous trouverez en "attach" les fichiers gerber (RS274X) des positions 1 2 et 10. Les circuits de 2 à 10 sont de même structures, la longueur et le nombre connexions sont différentes.

Pouvez vous nous faire savoir si vous êtes en mesure de répondre à cette demande.

Si oui pouvez vous nous indiquer dans quelles conditions.

Responsable du projet :

Mr LEVTCHENKO Peter

Division EP

CERN

1211 Genève 23

Tel : 00 41 22 767 65 70

GSM : 00 41 79 201 05 37.

Pour le bureau d'études :

Monfort Alain Alain.Monfort@cern.ch

Division EP

CERN

1211 Genève 23

00 41 22 767 83 72 Fax 00 41 22 767 46 00

Ou le dessinateur en charge :

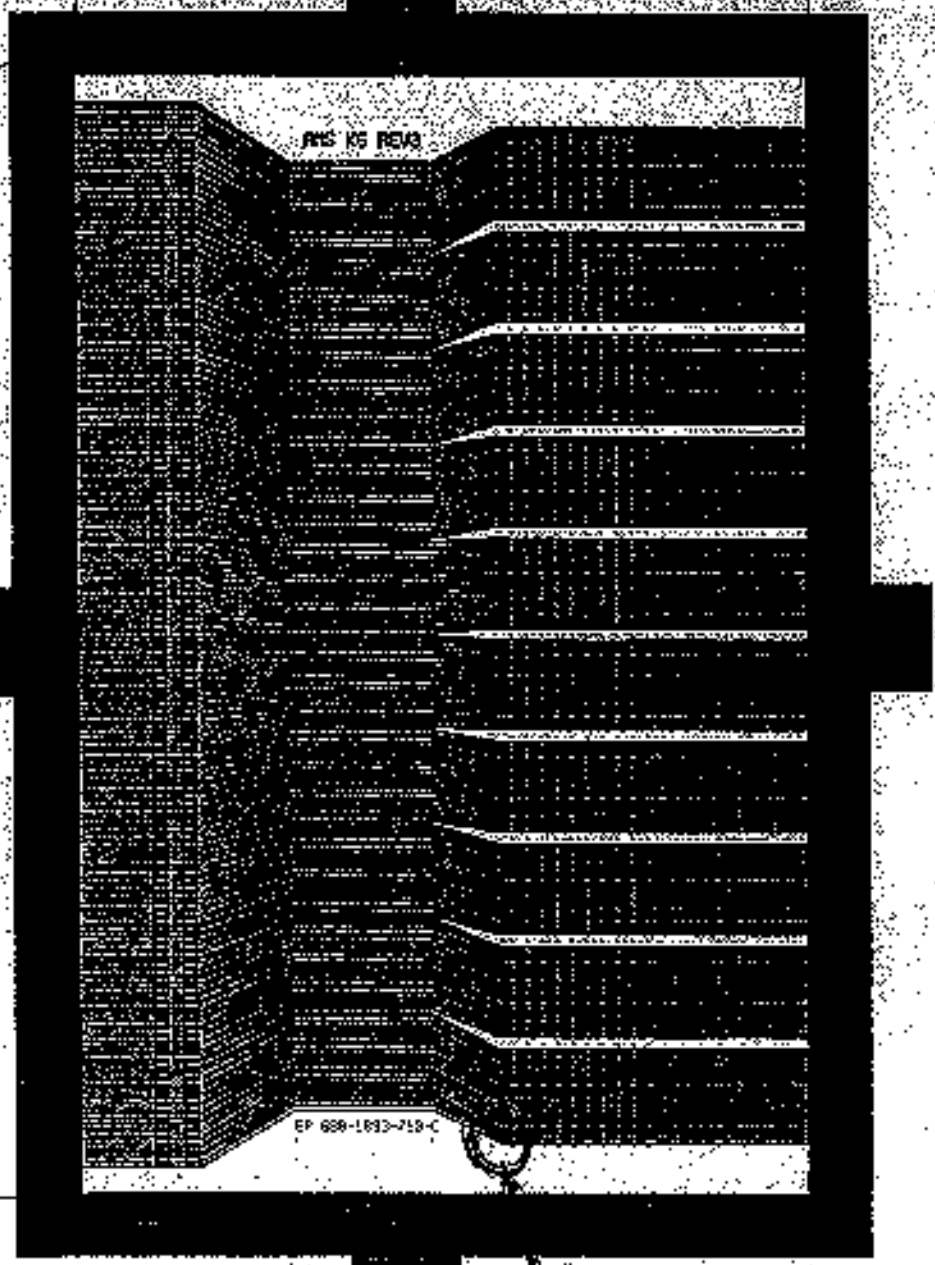
Mr SANCHEZ Manuel.Sanchez@cern.ch

00 41 22 767 34 03

20.31mm

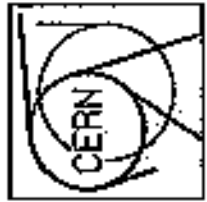
74mm

48mm



Voire  
Detail B

EP 680-1093-710	MOULÉ C	Nbre de couche : 1
DESS SANCHEZ.M		Ep. du cuivre : 5u
DATE 14/06/2000		Ep. du circuit : 50u
		Matière du CI : KAPTON



EP/PES

Position 2 - 1093.723.B.

2 3.4 d'axe<sup>2</sup>

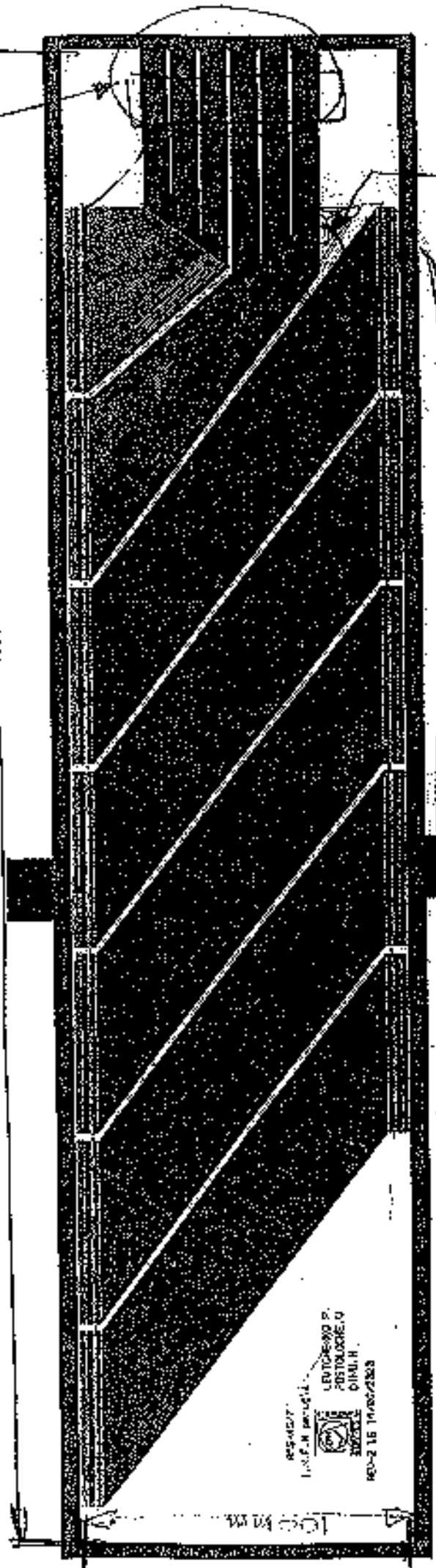
Voie Detail C

ByOmnis.

Voie Detail A

Detail D.

Plats de Bonding  
Sur les 2 cotés.



REDACTEUR  
LENTIC-202 P.  
POSTOLOGIE U  
DINA H.  
RD-2 15 10/02/2008

EP 500-1630-723	18	Plan de coupe 1
		Plan de coupe 2
DESS SINGHER, N	14/03/2008	Plan de coupe 3
		Plan de coupe 4
EP/DES		

2 73m<sup>2</sup>

Position 10 - 1093.720.c

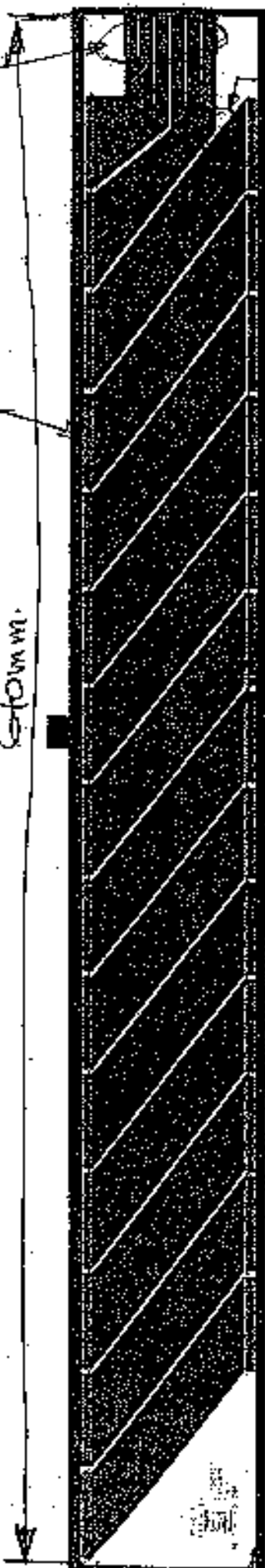
Voire Detail C

Detail D

Stamm

Voire Detail A

Plat de Barding sur les 2 cotés  
Voire Detail D

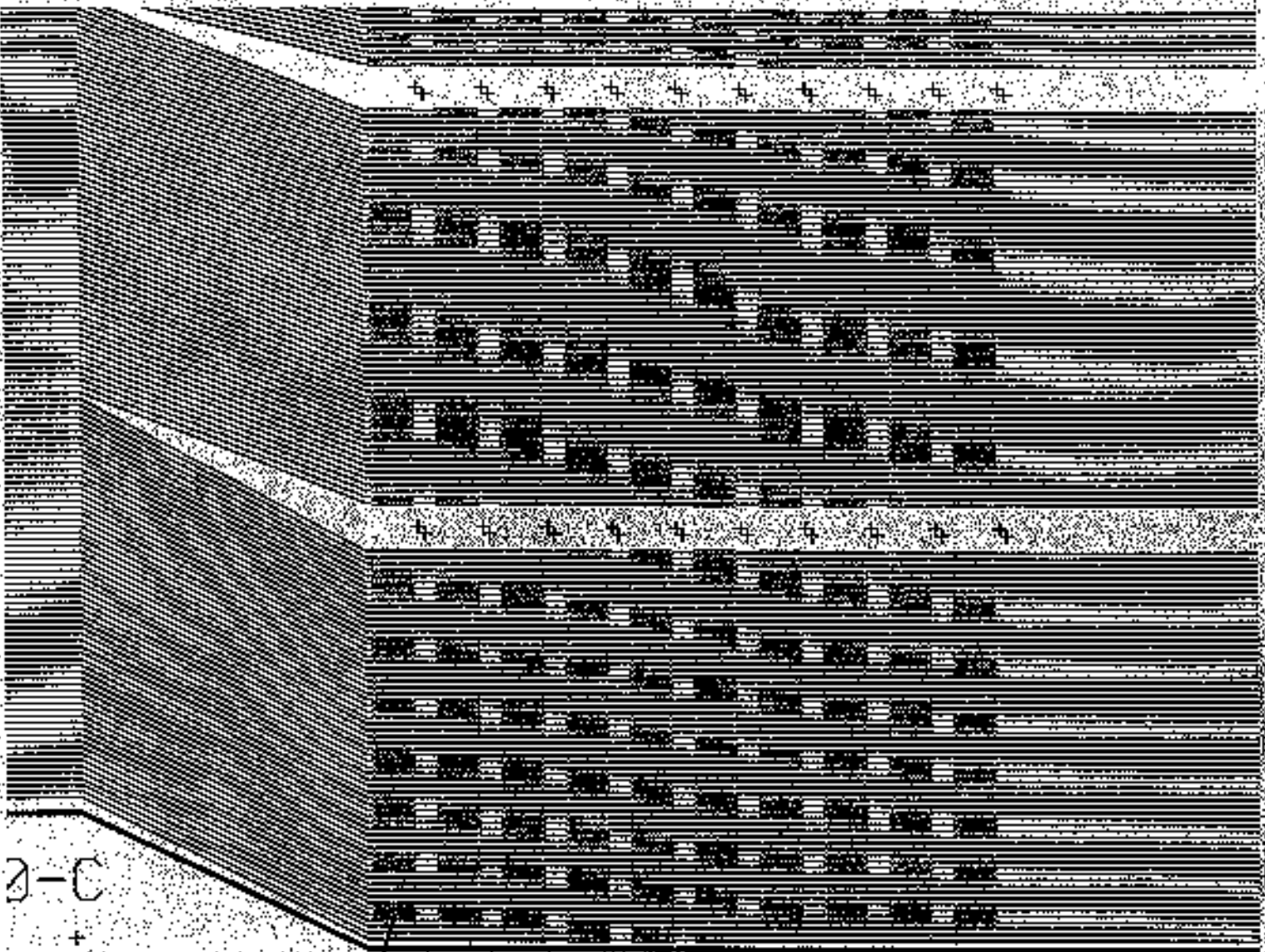


PROJET	1093.720.c
DATE	15/08/2000
DESIGNER	...
CHECKER	...
APPROVED	...

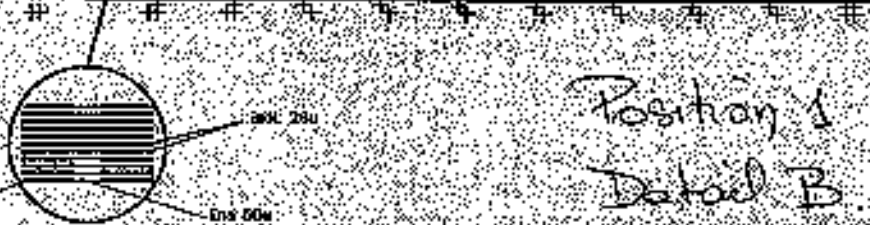
line 50u  
isol 18u

DETAIL A

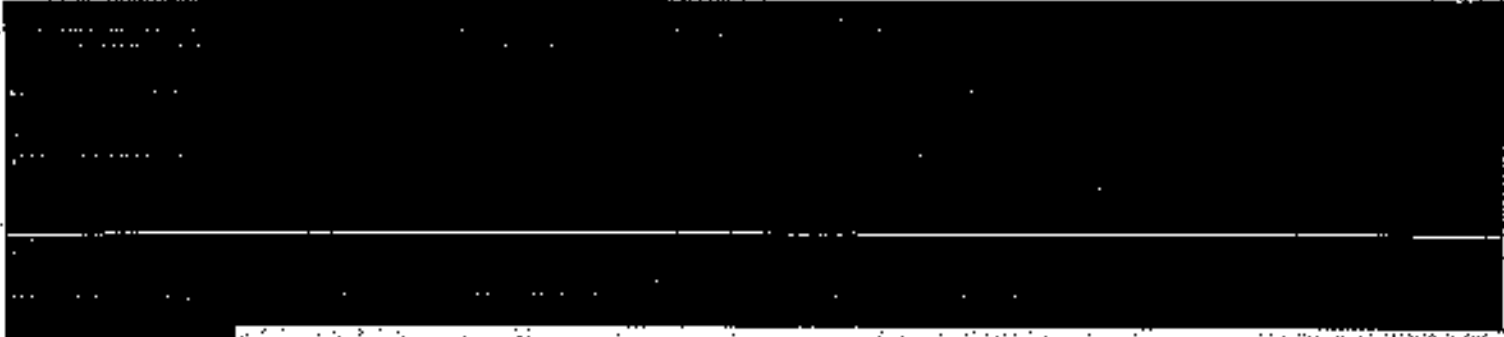
Position 2 et 10  
-1093-723B  
-1093 720C

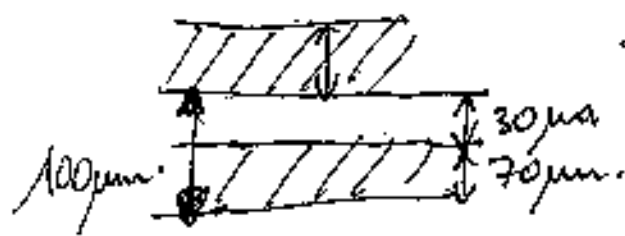
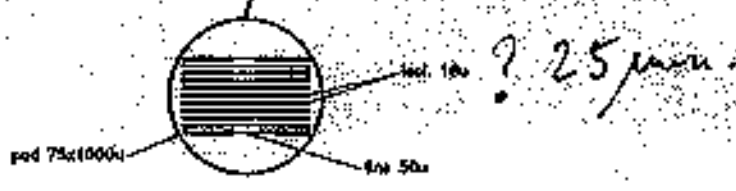
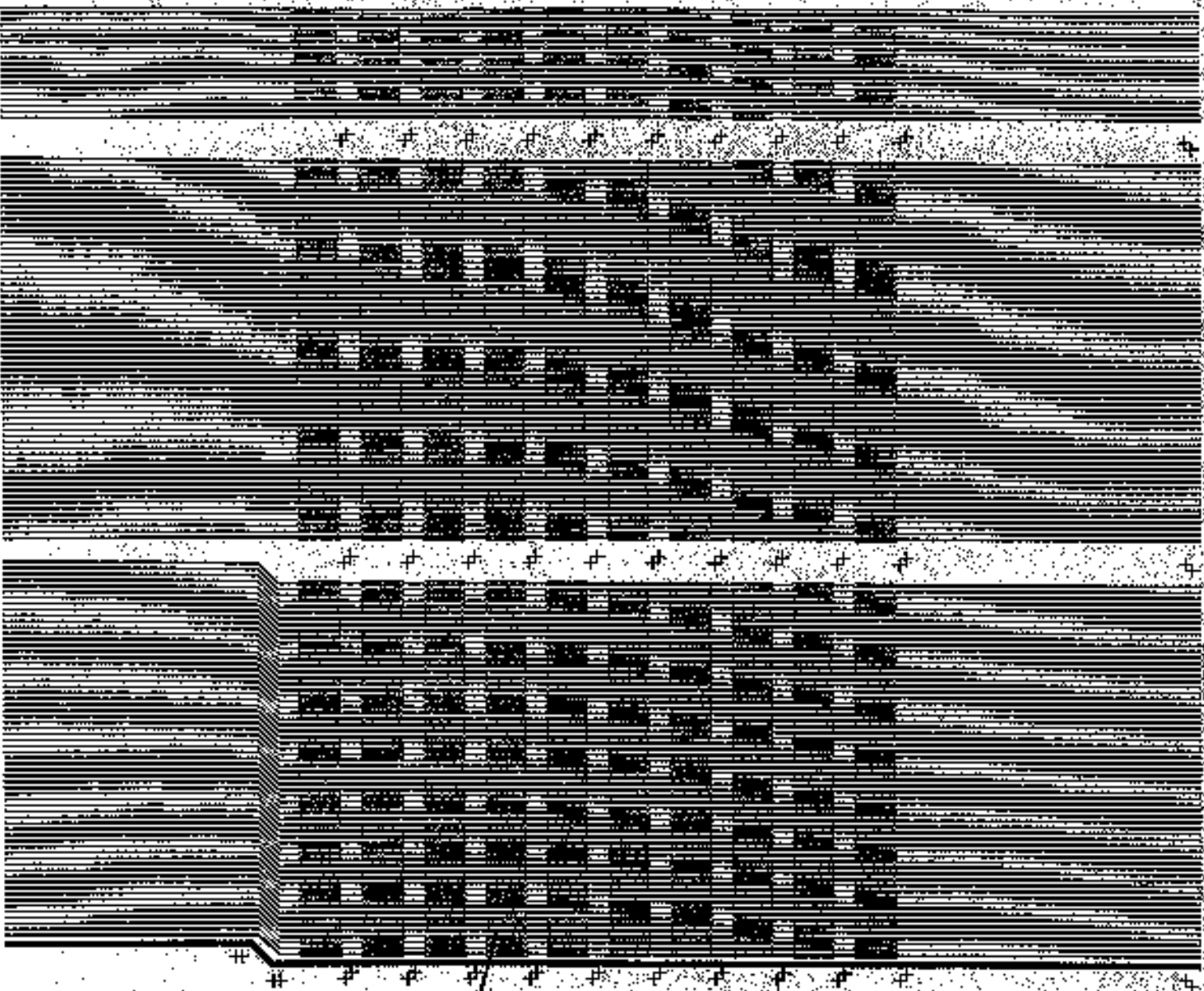


B-C



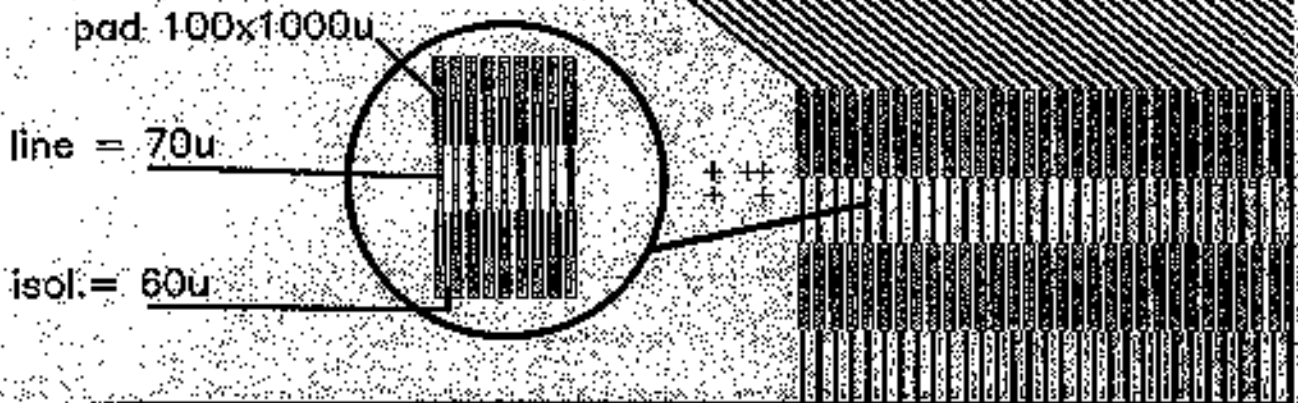
Position 1  
Detail B





Position 2 a 10  
Detail C

*Handwritten scribble or signature.*



Position 2e 10.  
Plots de Bonding.  
DETAIL D